Symbol	Typ	Titel
H	**Sektion**	**Sektion H — Elektrotechnik**
H01	**Klasse**	**Elektrische Bauteile**
H01L	**Unterklasse**	**Halbleiterbauelemente; die nicht von Klasse H10 umfasst sind (Anwendung von Halbleiterbauelementen für Messzwecke G01; Widerstände allgemein H01C; Magnete, Induktoren oder Umformer H01F; Kondensatoren allgemein H01G; elektrolytische Bauelemente H01G 9/00; Batterien oder Akkumulatoren H01M; Wellenleiter, Resonatoren oder Übertragungsleitungen des Wellenleitertyps H01P; Leitungsverbinder oder Stromabnehmer H01R; Bauelemente mit stimulierter Emission H01S; elektromechanische Resonatoren H03H; Lautsprecher, Mikrofone, Plattenspieler oder sonstige akustische elektromechanische Wandler H04R; elektrische Lichtquellen allgemein H05B; gedruckte Schaltungen, Hybridschaltungen, Gehäuse oder bauliche Einzelheiten von elektrischen Geräten, Herstellung von Baugruppen aus elektrischen Schaltungselementen H05K; Anwendung von Halbleiterbauelementen in Schaltungen für besondere Anwendungen, siehe die Unterklasse für die Anwendung) [2]**
H01L 21/00	**Hauptgruppe**	**Verfahren oder Vorrichtungen, besonders ausgebildet für die Herstellung oder Behandlung von Halbleiterbauelementen oder Festkörperbauelementen, oder von Teilen davon [2, 2006.01]**
H01L 21/02	1-Punkt Untergruppe	. Herstellung oder Behandlung von Halbleiterbauelementen oder Teilen davon [2, 2006.01]
H01L 21/027	2-Punkt Untergruppe	. . Herstellung von Masken auf Halbleiterkörpern für ein folgendes fotolithografisches Verfahren, soweit nicht von H01L 21/18 oder H01L 21/34 umfasst [5, 2006.01]
H01L 21/033	3-Punkt Untergruppe	. . . aus anorganischen Schichten [5, 2006.01]
H01L 21/04	2-Punkt Untergruppe	. . Bauelemente mit Potenzial-Sperrschicht, z.B. ein PN-Übergang, Verarmungsschicht oder Anreicherungsschicht [2, 2006.01]
H01L 21/06	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/04)
H01L 21/08	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/042)
H01L 21/10	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/043)
H01L 21/103	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/044)
H01L 21/105	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/045)
H01L 21/108	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/046)
H01L 21/12	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/047)
H01L 21/14	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/048)
H01L 21/145	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/049)
H01L 21/16	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/07)
H01L 21/18	3-Punkt Untergruppe	. . . Bauelemente mit Halbleiterkörpern aus Elementen der Gruppe IV des Periodensystems oder $A_{III}B_{V}$-Verbindungen mit oder ohne Fremdstoffe, z.B. Dotierungsmaterialien [2, 6, 7, 2006.01]
H01L 21/20	4-Punkt Untergruppe	. . . . Ablagerung von Halbleitermaterialien auf einem Substrat, z.B. epitaxiales Aufwachsen [2, 2006.01]
H01L 21/203	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch physikalische Ablagerung, z.B. Aufdampfen in Vakuum, Kathodenzerstäubung [2, 2006.01]
H01L 21/205	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Reduktion oder Zerlegung einer gasförmigen Verbindung, die ein festes Kondensat ergibt, d.h. chemische Ablagerung [2, 2006.01]
H01L 21/208	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Ablagerung aus der flüssigen Phase [2, 2006.01]
H01L 21/22	4-Punkt Untergruppe	. . . . Diffusion von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen oder aus einem Halbleiterkörper oder zwischen Halbleiterbereichen; Rückverteilung von Fremdstoffen, z.B. ohne Zuführen oder Entfernen von weiteren Dotierstoffen [2, 2006.01]
H01L 21/223	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine gasförmige Phase [2, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H01L 21/225	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine feste Phase, z.B. eine dotierte Oxidschicht [2, 2006.01]
H01L 21/228	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine flüssige Phase, z.B. Legierungs-Diffusions-Verfahren [2, 2006.01]
H01L 21/24	4-Punkt Untergruppe	. . . . Einlegieren von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen Halbleiterkörper [2, 2006.01]
H01L 21/26	4-Punkt Untergruppe	. . . . Beschuss mit Wellenstrahlung oder Korpuskularstrahlung [2, 2006.01]
H01L 21/261	5-Punkt Untergruppe	. . . . . um durch Kernumwandlung transmutierte chemische Elemente zu erzeugen [6, 2006.01]
H01L 21/263	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit hochenergetischer Strahlung (H01L 21/261 hat Vorrang) [2, 6, 2006.01]
H01L 21/265	6-Punkt Untergruppe	. . . . . wobei Ionenimplantation erzeugt wird [2, 2006.01]
H01L 21/266	7-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Masken [5, 2006.01]
H01L 21/268	6-Punkt Untergruppe	. . . . . mit elektromagnetischer Strahlung, z.B. Laser-Strahlung [2, 2006.01]
H01L 21/28	*4-Punkt Untergruppe*	*. . . . Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkörpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht in H01L 21/20-H01L 21/268 vorgesehen [2, 2006.01, 2025.01]*
H01L 21/283	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Ablagerung von leitenden oder isolierenden Materialien für Elektroden [2, 2006.01]
H01L 21/285	6-Punkt Untergruppe	. . . . . aus der Gasphase oder Dampfphase, z.B. Kondensation [2, 2006.01]
H01L 21/288	6-Punkt Untergruppe	. . . . . aus der flüssigen Phase, z.B. elektrolytische Ablagerung [2, 2006.01]
H01L 21/30	4-Punkt Untergruppe	. . . . Behandlung von Halbleiterkörpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht von H01L 21/20-H01L 21/26 umfasst (Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkörpern H01L 21/28, H10D 64/01) [2, 2006.01]
H01L 21/301	5-Punkt Untergruppe	. . . . . zur Unterteilung eines Halbleiterkörpers in Einzelelemente (Sägen, Schneiden H01L 21/304) [6, 2006.01]
H01L 21/302	5-Punkt Untergruppe	. . . . . zur Änderung der physikalischen Oberflächenbeschaffenheit oder zur Änderung der Form, z.B. Ätzen, Polieren, Sägen, Schneiden [2, 2006.01]
H01L 21/304	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Mechanische Behandlung, z.B. Schleifen, Polieren, Sägen, Schneiden [2, 2006.01]
H01L 21/306	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Chemische oder elektrische Behandlung, z.B. elektrolytisches Ätzen (zur Bildung isolierender Schichten H01L 21/31; Nachbehandlung isoliernder Schichten H01L 21/3105) [2, 2006.01]
H01L 21/3063	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Elektrolytisches Ätzen [6, 2006.01]
H01L 21/3065	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Plasmaätzen; Reaktives Ionenätzen [6, 2006.01]
H01L 21/308	7-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Masken (H01L 21/3063 , H01L 21/3065 haben Vorrang) [2, 6, 2006.01]
H01L 21/31	5-Punkt Untergruppe	. . . . . zur Bildung isolierender Schichten auf Halbleiterkörpern, z.B. für Maskierungszwecke oder bei Verwendung fotolithografischer Techniken (Schutzschichten H01L 21/56); Nachbehandlung dieser Schichten; Auswahl von Materalien für diese Schichten [2, 5, 2006.01]
H01L 21/3105	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Nachbehandlung [5, 2006.01]
H01L 21/311	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Ätzen isolierender Schichten [5, 2006.01]
H01L 21/3115	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Dotieren isolierender Schichten [5, 2006.01]
H01L 21/312	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Organische Schichten, z.B. Fotolack (H01L 21/3105 , H01L 21/32 haben Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 21/314	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Anorganische Schichten (H01L 21/3105 , H01L 21/32 haben Vorrang) [2, 5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H01L 21/316	7-Punkt Untergruppe	. . . . . zusammengesetzt aus Oxiden oder glasigen Oxiden oder Gläsern auf Oxidbasis [2, 2006.01]
H01L 21/318	7-Punkt Untergruppe	. . . . . zusammengesetzt aus Nitriden [2, 2006.01]
H01L 21/32	6-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Masken [2, 5, 2006.01]
H01L 21/3205	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Aufbringen nicht isolierender Schichten, z.B. leitender Schichten oder Widerstandsschichten auf isolierende Schichten; Nachbehandlung dieser Schichten (Herstellung von Elektroden H01L 21/28, H10D 64/01) [5, 2006.01]
H01L 21/321	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Nachbehandlung [5, 2006.01]
H01L 21/3213	8-Punkt Untergruppe	. . . . . Physikalisches oder chemisches Ätzen der Schichten, z.B. um eine gemusterte Schicht aus einer zuvor durchgehend abgeschiedenen Schicht zu erzeugen [6, 2006.01]
H01L 21/3215	8-Punkt Untergruppe	. . . . . Dotieren der Schichten [5, 2006.01]
H01L 21/322	5-Punkt Untergruppe	. . . . . zur Änderung ihrer inneren Eigenschaften, z.B. zur Erzeugung von Gitterfehlern [2, 2006.01]
H01L 21/324	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Thermische Behandlung zum Ändern der Eigenschaften von Halbleiterkörpern, z.B. Tempern, Sintern (H01L 21/20-H01L 21/288 und H01L 21/302-H01L 21/322 haben Vorrang) [2, 2006.01]
H01L 21/326	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Anwendung von elektrischen Strömen oder Feldern, z.B. zur Elektroformierung (H01L 21/20-H01L 21/288 und H01L 21/302-H01L 21/324 haben Vorrang) [2, 2006.01]
H01L 21/328	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/01)
H01L 21/329	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/01; H10D 48/01)
H01L 21/33	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/01)
H01L 21/331	Gelöscht	(überführt nach H10D 10/01; H10D 12/01)
H01L 21/332	Gelöscht	(überführt nach H10D 18/01)
H01L 21/334	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/01)
H01L 21/335	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/01)
H01L 21/336	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/01)
H01L 21/337	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/01)
H01L 21/338	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/01)
H01L 21/339	Gelöscht	(überführt nach H10D 44/01)
H01L 21/34	*3-Punkt Untergruppe*	*. . . Bauelemente mit Halbleiterkörpern, soweit nicht von H01L 21/18 , H10D 48/04 und H10D 48/07 umfasst, mit oder ohne Fremdstoffe, z.B. Dotierungsmaterialien [2, 2006.01, 2025.01]*
H01L 21/36	4-Punkt Untergruppe	. . . . Ablagerung von Halbleitermaterialien auf einem Substrat, z.B. epitaxiales Aufwachsen [2, 2006.01]
H01L 21/363	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch physikalische Ablagerung, z.B. Aufdampfen in Vakuum, Kathodenzerstäubung [2, 2006.01]
H01L 21/365	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Reduktion oder Zerlegung einer gasförmigen Verbindung, die ein festes Kondensat ergibt, d.h. chemische Ablagerung [2, 2006.01]
H01L 21/368	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Ablagerung aus der flüssigen Phase [2, 2006.01]
H01L 21/38	4-Punkt Untergruppe	. . . . Diffusion von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen oder aus einem Halbleiterkörper oder zwischen Halbleiterbereichen [2, 2006.01]
H01L 21/383	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine gasförmige Phase [2, 2006.01]
H01L 21/385	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine feste Phase, z.B. eine dotierte Oxidschicht [2, 2006.01]
H01L 21/388	5-Punkt Untergruppe	. . . . . durch Diffusion in einen oder aus einem Festkörper aus einer oder in eine flüssige Phase, z.B. Legierungs-Diffusions-Verfahren [2, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H01L 21/40	4-Punkt Untergruppe	. . . . Einlegieren von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen Halbleiterkörper [2, 2006.01]
H01L 21/42	4-Punkt Untergruppe	. . . . Beschuss mit Strahlung [2, 2006.01]
H01L 21/423	5-Punkt Untergruppe	. . . . . mit hochenergetischer Strahlung [2, 2006.01]
H01L 21/425	6-Punkt Untergruppe	. . . . . wobei Ionenimplantation erzeugt wird [2, 2006.01]
H01L 21/426	7-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Masken [5, 2006.01]
H01L 21/428	6-Punkt Untergruppe	. . . . . mit elektromagnetischer Strahlung, z.B. Laser-Strahlung [2, 2006.01]
H01L 21/44	*4-Punkt Untergruppe*	*. . . . Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkörpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht in H01L 21/36-H01L 21/428 vorgesehen [2, 2006.01, 2025.01]*
H01L 21/441	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Ablagerung von leitenden oder isolierenden Materialien für Elektroden [2, 2006.01]
H01L 21/443	6-Punkt Untergruppe	. . . . . aus der Gasphase oder Dampfphase, z.B. Kondensation [2, 2006.01]
H01L 21/445	6-Punkt Untergruppe	. . . . . aus der flüssigen Phase, z.B. elektrolytische Ablagerung [2, 2006.01]
H01L 21/447	5-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Anwendung von Druck, z.B. Thermokompression (H01L 21/607 hat Vorrang) [2, 2006.01]
H01L 21/449	5-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Anwendung mechanischer Schwingungen, z.B. Ultraschallschwingungen [2, 2006.01]
H01L 21/46	4-Punkt Untergruppe	. . . . Behandlung von Halbleiterkörpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht in H01L 21/36-H01L 21/428 vorgesehen (Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkörpern H01L 21/44, H10D 64/01) [2, 2006.01]
H01L 21/461	5-Punkt Untergruppe	. . . . . zur Änderung der physikalischen Eigenschaften ihrer Oberfläche oder ihrer Form, z.B. Ätzen, Polieren, Schneiden [2, 2006.01]
H01L 21/463	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Mechanische Behandlung, z.B. Schleifen, Ultraschallbehandlung [2, 2006.01]
H01L 21/465	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Chemische oder elektrische Behandlung, z.B. elektrolytisches Ätzen (zur Bildung isolierender Schichten H01L 21/469) [2, 2006.01]
H01L 21/467	7-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Masken [2, 2006.01]
H01L 21/469	6-Punkt Untergruppe	. . . . . zur Bildung isolierender Schichten auf Halbleiterkörpern, z.B. für Maskierungszwecke oder bei Verwendung fotolithografischer Techniken (Schutzschichten H01L 21/56); Nachbehandlung dieser Schichten [2, 5, 2006.01]
H01L 21/47	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Organische Schichten, z.B. Fotolack (H01L 21/475 , H01L 21/4757 haben Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 21/471	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Anorganische Schichten (H01L 21/475 , H01L 21/4757 haben Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 21/473	8-Punkt Untergruppe	. . . . . zusammengesetzt aus Oxiden oder glasigen Oxiden oder Gläsern auf Oxidbasis [2, 2006.01]
H01L 21/475	7-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Verwendung von Masken [2, 5, 2006.01]
H01L 21/4757	7-Punkt Untergruppe	. . . . . Nachbehandlung [5, 2006.01]
H01L 21/4763	6-Punkt Untergruppe	. . . . . Aufbringen nicht isolierender Schichten, z.B. leitender Schichten oder Widerstandsschichten auf isolierende Schichten; Nachbehandlung dieser Schichten (Herstellung von Elektroden H01L 21/28, H10D 64/01) [5, 2006.01]
H01L 21/477	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Thermische Behandlung zum Ändern der Eigenschaften von Halbleiterkörpern, z.B. Tempern, Sintern (H01L 21/36-H01L 21/449 und H01L 21/461-H01L 21/475 haben Vorrang) [2, 2006.01]
H01L 21/479	5-Punkt Untergruppe	. . . . . Anwendung von elektrischen Strömen oder Feldern, z.B. zur Elektroformierung (H01L 21/36-H01L 21/449 und H01L 21/461-H01L 21/477 haben Vorrang) [2, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H01L 21/48	3-Punkt Untergruppe	. . . Herstellung oder Behandlung von Teilen, z.B. Gehäusen, vor dem Zusammenbau der Bauelemente unter Verwendung von Verfahren, soweit diese nicht in einer der Untergruppen H01L 21/18-H01L 21/326 oder H10D 48/04-H10D 48/07 vorgesehen sind [2, 2006.01]
H01L 21/50	3-Punkt Untergruppe	. . . Zusammenbau von Halbleiterbauelementen unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht in einer der Untergruppen H01L 21/18-H01L 21/326 oder H10D 48/04-H10D 48/07 vorgesehen [2, 2006.01]
H01L 21/52	4-Punkt Untergruppe	. . . . Einbau von Halbleiterkörpern in Gehäuse [2, 2006.01]
H01L 21/54	4-Punkt Untergruppe	. . . . Einbringen von Füllungen in Gehäuse, z.B. Gasfüllungen [2, 2006.01]
H01L 21/56	4-Punkt Untergruppe	. . . . Einkapselungen, z.B. Schutzschichten, Überzüge [2, 2006.01]
H01L 21/58	4-Punkt Untergruppe	. . . . Montage von Halbleiterbauelementen auf Unterlagen [2, 2006.01]
H01L 21/60	4-Punkt Untergruppe	. . . . Anbringen von Anschlussleitungen oder anderen leitenden Teilen, die zur Stromleitung zu oder von einem in Betrieb befindlichen Bauelement dienen [2, 2006.01]
H01L 21/603	5-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Anwendung von Druck, z.B. Thermokompression (H01L 21/607 hat Vorrang) [2, 2006.01]
H01L 21/607	5-Punkt Untergruppe	. . . . . unter Anwendung mechanischer Schwingungen, z.B. Ultraschallschwingungen [2, 2006.01]
H01L 21/62	2-Punkt Untergruppe	. . Bauelemente ohne Potenzial-Sperrschicht [2, 2006.01]
H01L 21/64	1-Punkt Untergruppe	. Herstellung oder Behandlung von anderen Festkörperbauelementen als Halbleiterbauelementen oder Teilen davon, die nicht besonders ausgebildet sind für eine einzige Art von Bauelement, das von den Unterklassen H10F, H10H, H10K oder H10N umfasst ist [2, 2006.01]
H01L 21/66	1-Punkt Untergruppe	. Prüfen oder Messen während der Herstellung oder Behandlung [2, 2006.01]
H01L 21/67	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen, besonders ausgebildet zur Handhabung von Halbleiterbauelementen oder elektrischen Festkörperbauelementen während ihrer Herstellung oder Behandlung; Vorrichtungen, besonders ausgebildet zur Handhabung von Wafern während der Herstellung oder Behandlung von Halbleiterbauelementen, elektrischen Festkörperbauelementen oder einzelnen Schaltungselementen [2006.01]
H01L 21/673	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung besonders ausgebildeter Trägersysteme [2006.01]
H01L 21/677	2-Punkt Untergruppe	. . zum Transportieren oder Fördern, z.B. zwischen verschiedenen Bearbeitungsstationen [2006.01]
H01L 21/68	2-Punkt Untergruppe	. . zum Positionieren, Orientieren oder Justieren [2, 2006.01]
H01L 21/683	2-Punkt Untergruppe	. . zum Aufnehmen oder Greifen (zum Positionieren, Orientieren oder Justieren H01L 21/68) [2006.01]
H01L 21/687	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mechanischen Mitteln, z.B. Haltevorrichtungen, Klemmvorrichtungen oder Pressvorrichtungen [2006.01]
H01L 21/70	1-Punkt Untergruppe	. Herstellung oder Behandlung von Bauelementanordnungen bestehend aus einer Vielzahl von einzelnen Schaltungselementen oder integrierten Schaltungen, die in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildet sind, oder von bestimmten Teilen hiervon; Herstellung von integrierten Schaltungsanordnungen oder von bestimmten Teilen hiervon (Herstellung von Bauelementen, die aus vorgefertigten elektrischen Schaltungselementen bestehen, H05K 3/00 , H05K 13/00) [2, 2006.01]
H01L 21/71	2-Punkt Untergruppe	. . Herstellung von bestimmten Teilen der in Gruppe H01L 21/70 definierten Bauelemente (H01L 21/28, H01L 21/44, H01L 21/48 und H10D 64/01 haben Vorrang) [6, 2006.01]
H01L 21/74	3-Punkt Untergruppe	. . . Ausbildung von vergrabenen Bereichen hoher Fremdstoffkonzentration, z.B. von vergrabenen Kollektorschichten, inneren Verbindungen [2, 2006.01]
H01L 21/76	3-Punkt Untergruppe	. . . Ausbildung von isolierenden Bereichen zwischen Schaltungselementen [2, 2006.01]
H01L 21/761	4-Punkt Untergruppe	. . . . PN-Übergänge [6, 2006.01]
H01L 21/762	4-Punkt Untergruppe	. . . . Dielektrische Bereiche [6, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H01L 21/763	4-Punkt Untergruppe	. . . . Polykristalline Halbleiterbereiche [6, 2006.01]
H01L 21/764	4-Punkt Untergruppe	. . . . Luftspalte [6, 2006.01]
H01L 21/765	4-Punkt Untergruppe	. . . . durch Feldeffekt isolierende Bereiche [6, 2006.01]
H01L 21/768	3-Punkt Untergruppe	. . . Anbringen von Verbindungsleitungen, die zur Stromführung zwischen einzelnen Schaltungselementen innerhalb eines Bauelements dienen [6, 2006.01]
H01L 21/77	2-Punkt Untergruppe	. . Herstellung oder Behandlung von Bauelementanordnungen bestehend aus einer Vielzahl von einzelnen Schaltungselementen oder integrierten Schaltungen, die in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildet sind (Herstellung oder Behandlung von elektronischen Speicherbauelementen H10B) [6, 2006.01, 2017.01]
H01L 21/78	3-Punkt Untergruppe	. . . mit nachfolgender Unterteilung des Substrats in eine Vielzahl einzelner Bauelemente (Sägen oder Schneiden zur Änderung der physikalischen Oberflächenbeschaffenheit oder der Form des Halbleiterkörpers H01L 21/304) [2, 6, 2006.01]
H01L 21/782	Gelöscht	(überführt nach H10D 99/00)
H01L 21/784	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/01)
H01L 21/786	Gelöscht	(überführt nach H10D 86/01)
H01L 21/82	Gelöscht	(überführt nach H10D 99/00; H10D 89/00-H10D 89/10)
H01L 21/822	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8222	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8224	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8226	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8228	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8232	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8234	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8236	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8238	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8248	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8249	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/03)
H01L 21/8252	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/05)
H01L 21/8254	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/07)
H01L 21/8256	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/02-H10D 84/03)
H01L 21/8258	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/08)
H01L 21/84	Gelöscht	(überführt nach H10D 86/01)
H01L 21/86	Gelöscht	(überführt nach H10D 86/03)
H01L 21/98	2-Punkt Untergruppe	. . Zusammenbau von Bauelementen, die aus, in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildeten Festkörperschaltungselementen bestehen; Zusammenbau von integrierten Schaltungsanordnungen (H01L 21/50 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 23/00	**Hauptgruppe**	**Einzelheiten von Halbleiterbauelementen oder anderen Festkörperbauelementen (H01L 25/00 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01]**
H01L 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Gehäuse; Abdichtungen (H01L 23/12 , H01L 23/34 , H01L 23/48 , H01L 23/552 haben Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 23/04	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Form [2, 2006.01]
H01L 23/043	3-Punkt Untergruppe	. . . Gehäuse mit einem Hohlraum und einer leitenden Grundplatte, die als Montagesockel und als Zuleitung für den Halbleiterkörper dient [5, 2006.01]
H01L 23/045	4-Punkt Untergruppe	. . . . wobei die anderen Zuleitungen isolierte Durchführungen durch die Grundplatte aufweisen [5, 2006.01]
H01L 23/047	4-Punkt Untergruppe	. . . . wobei die anderen Zuleitungen parallel zur Grundplatte angeordnet sind [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H01L 23/049	4-Punkt Untergruppe	. . . . wobei die anderen Zuleitungen senkrecht zur Grundplatte angeordnet sind [5, 2006.01]
H01L 23/051	4-Punkt Untergruppe	. . . . wobei eine andere Zuleitung aus einer parallel zur Grundplatte angeordneter Deckplatte besteht, z.B. Sandwich-Typ [5, 2006.01]
H01L 23/053	3-Punkt Untergruppe	. . . Gehäuse mit einem Hohlraum und mit einer isolierenden Grundplatte als Montagesockel für den Halbleiterkörper [5, 2006.01]
H01L 23/055	4-Punkt Untergruppe	. . . . wobei die Zuleitungen durch die Grundplatte gehen [5, 2006.01]
H01L 23/057	4-Punkt Untergruppe	. . . . wobei die Zuleitungen parallel zur Grundplatte angeordnet sind [5, 2006.01]
H01L 23/06	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch das Material des Gehäuses oder dessen elektrische Eigenschaften [2, 2006.01]
H01L 23/08	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei das Material ein elektrischer Isolator ist, z.B. Glas [2, 2006.01]
H01L 23/10	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch das Material oder die Anordnung der Abdichtung zwischen Teilen, z.B. zwischen den Gehäusekappen und der Grundplatte oder zwischen den Leitern und den Gehäusewänden [2, 2006.01]
H01L 23/12	1-Punkt Untergruppe	. Montagesockel, z.B. nicht lösbare isolierende Substrate [2, 2006.01]
H01L 23/13	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Form [5, 2006.01]
H01L 23/14	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch das Material oder dessen elektrische Eigenschaften [2, 2006.01]
H01L 23/15	3-Punkt Untergruppe	. . . Substrate aus Keramik oder Glas [5, 2006.01]
H01L 23/16	1-Punkt Untergruppe	. Füllungen oder Hilfsmittel im Gehäuse, z.B. Zentrierringe (H01L 23/42 , H01L 23/552 haben Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 23/18	2-Punkt Untergruppe	. . Füllungen gekennzeichnet durch das Material oder dessen physikalische oder chemische Eigenschaften oder dessen Anordnung innerhalb des vollständigen Bauelements [2, 2006.01]
H01L 23/20	3-Punkt Untergruppe	. . . gasförmig bei der normalen Betriebstemperatur des Bauelements [2, 2006.01]
H01L 23/22	3-Punkt Untergruppe	. . . flüssig bei der normalen Betriebstemperatur des Bauelements [2, 2006.01]
H01L 23/24	3-Punkt Untergruppe	. . . fest oder gelartig bei der normalen Betriebstemperatur des Bauelements [2, 2006.01]
H01L 23/26	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Materialien, die Feuchtigkeit oder andere unerwünschte Substanzen absorbieren oder mit ihnen reagieren [2, 2006.01]
H01L 23/28	1-Punkt Untergruppe	. Einkapselungen, z.B. Schutzschichten, Überzüge (H01L 23/552 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 23/29	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch das Material [5, 2006.01]
H01L 23/31	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch die Anordnung [5, 2006.01]
H01L 23/32	1-Punkt Untergruppe	. Befestigungsvorrichtungen zur Halterung des vollständigen Bauelements beim Betrieb, z.B. lösbare Befestigungen (H01L 23/40 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 23/34	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zum Kühlen, Heizen, Belüften oder zur Temperaturkompensation [2, 5, 2006.01]
H01L 23/36	2-Punkt Untergruppe	. . Auswahl des Materials oder der Form, um die Kühlung oder Heizung zu erleichtern, z.B. Wärmesenken [2, 2006.01]
H01L 23/367	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Kühlung durch die Form des Bauelements bewirkt wird [5, 2006.01]
H01L 23/373	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Kühlung durch das gewählte Material des Bauelements bewirkt wird [5, 2006.01]
H01L 23/38	2-Punkt Untergruppe	. . Kühleinrichtungen, die vom Peltier-Effekt Gebrauch machen [2, 2006.01]
H01L 23/40	2-Punkt Untergruppe	. . Montagemittel oder Befestigungsmittel für lösbare Kühleinrichtungen oder Heizeinrichtungen [2, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H01L 23/42	2-Punkt Untergruppe	. . Füllungen oder Hilfsmittel in den Gehäusen, die so ausgewählt oder angeordnet sind, dass sie die Heizwirkung oder Kühlwirkung erhöhen [2, 5, 2006.01]
H01L 23/427	3-Punkt Untergruppe	. . . Kühlung durch Zustandsänderung, z.B. Verwendung von Wärmerohren [5, 2006.01]
H01L 23/433	3-Punkt Untergruppe	. . . Hilfsmittel, gekennzeichnet durch ihre Form, z.B. Stempel [5, 2006.01]
H01L 23/44	2-Punkt Untergruppe	. . das vollständige Bauelement ist ganz in ein Gas oder eine Flüssigkeit - außer Luft - eingetaucht (H01L 23/427 hat Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 23/46	2-Punkt Untergruppe	. . unter Ausnützung der Wärmeübertragung durch strömende Gase oder Flüssigkeiten (H01L 23/42 , H01L 23/44 haben Vorrang) [2, 2006.01]
H01L 23/467	3-Punkt Untergruppe	. . . durch strömende Gase, z.B. Luft [5, 2006.01]
H01L 23/473	3-Punkt Untergruppe	. . . durch strömende Flüssigkeiten [5, 2006.01]
H01L 23/48	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zur Stromleitung zu oder von dem im Betrieb befindlichen Festkörper, z.B. Zuleitungen oder Anschlüsse [2, 2006.01]
H01L 23/482	2-Punkt Untergruppe	. . bestehend aus Zuleitungsschichten, die untrennbar auf den Halbleiterkörper aufgebracht sind [5, 2006.01]
H01L 23/485	3-Punkt Untergruppe	. . . die schichtweise aus leitenden und isolierenden Schichten aufgebaut sind, z.B. Planar- Kontakte [5, 2006.01]
H01L 23/488	2-Punkt Untergruppe	. . bestehend aus gelöteten oder gebondeten Anordnungen [5, 2006.01]
H01L 23/49	3-Punkt Untergruppe	. . . drahtförmig [5, 2006.01]
H01L 23/492	3-Punkt Untergruppe	. . . Träger oder Platten [5, 2006.01]
H01L 23/495	3-Punkt Untergruppe	. . . Leiterrahmen [5, 2006.01]
H01L 23/498	3-Punkt Untergruppe	. . . Leiter auf isolierenden Substraten [5, 2006.01]
H01L 23/50	2-Punkt Untergruppe	. . für integrierte Schaltungsanordnungen (H01L 23/482-H01L 23/498 haben Vorrang) [2, 5, 2006.01]
H01L 23/52	1-Punkt Untergruppe	. Anordnungen zur Stromleitung innerhalb des im Betrieb befindlichen Bauelements von einem Schaltungselement zum anderen [2, 2006.01]
H01L 23/522	2-Punkt Untergruppe	. . einschließlich externer Verbindungsleitungen, die aus einer mehrschichtigen Anordnung aus leitenden und isolierenden Schichten aufgebaut und untrennbar an dem Halbleiterkörper angebracht sind [5, 2006.01]
H01L 23/525	3-Punkt Untergruppe	. . . mit anpassbaren Verbindungsleitungen [5, 2006.01]
H01L 23/528	3-Punkt Untergruppe	. . . Topografie der Verbindungsleitungen [5, 2006.01]
H01L 23/532	3-Punkt Untergruppe	. . . gekennzeichnet durch die Materialien [5, 2006.01]
H01L 23/535	2-Punkt Untergruppe	. . einschließlich interner Verbindungsleitungen, z.B. Unterkreuzungen [5, 2006.01]
H01L 23/538	2-Punkt Untergruppe	. . wobei die Verbindungsleitungen zwischen mehreren Halbleiterbauelementen auf oder in isolierenden Substraten angeordnet sind [5, 2006.01]
H01L 23/544	1-Punkt Untergruppe	. Markierungen auf Halbleiterbauelementen, z.B. Markierungen zu Kennzeichnungszwecken, Teststrukturen [5, 2006.01]
H01L 23/552	1-Punkt Untergruppe	. Schutz gegen Strahlung, z.B. Licht [5, 2006.01]
H01L 23/556	2-Punkt Untergruppe	. . gegen Alpha-Strahlung [5, 2006.01]
H01L 23/58	1-Punkt Untergruppe	. Strukturen von elektrischen Anordnungen für Halbleiterbauelemente, soweit nicht anderweitig vorgesehen [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
H01L 23/60	2-Punkt Untergruppe	. . Schutz gegen elektrostatische Aufladung oder Entladung, z.B. Faraday-Käfig [5, 2006.01]
H01L 23/62	2-Punkt Untergruppe	. . Schutz gegen Überstrom oder Überlastung, z.B. Sicherungen, Nebenschlüsse [5, 2006.01]
H01L 23/64	2-Punkt Untergruppe	. . Impedanz-Anpassung [5, 2006.01]
H01L 23/66	3-Punkt Untergruppe	. . . Hochfrequenz-Anpassung [5, 2006.01]
H01L 25/00	**Hauptgruppe**	**Baugruppen, die aus einer Mehrzahl von einzelnen Halbleiterbauelementen oder anderen Festkörperbauelementen bestehen (Bauelemente, die aus einer Mehrzahl von in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildeten Festkörperschaltungselementen bestehen, H10D 89/00; Photovoltaik [PV]-Module oder Anordnungen von photovoltaischen Zellen H10F 19/00) [2, 5, 2006.01]**
H01L 25/03	1-Punkt Untergruppe	. wobei alle Bauelemente von einer Art sind, wie sie in einer Unterklasse von H10B, H10D, H10F, H10H, H10K oder H10N vorgesehen sind, z.B. Baugruppen aus Gleichrichterdioden [5, 2006.01]
H01L 25/04	2-Punkt Untergruppe	. . wobei die Bauelemente keine gesonderten Gehäuse besitzen [2, 2006.01, 2014.01, 2023.01]
H01L 25/065	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Gruppe H10D 89/00 vorgesehen ist [5, 2006.01, 2023.01]
H01L 25/07	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Unterklasse H10D vorgesehen ist [5, 2006.01]
H01L 25/075	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Gruppe H10H 20/00 vorgesehen ist [5, 2006.01]
H01L 25/10	2-Punkt Untergruppe	. . wobei die Bauelemente gesonderte Gehäuse besitzen [2, 2006.01]
H01L 25/11	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Unterklasse H10D vorgesehen ist [5, 2006.01]
H01L 25/13	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Gruppe H10H 20/00 vorgesehen ist [5, 2006.01]
H01L 25/16	1-Punkt Untergruppe	. wobei die Bauelemente aus Arten bestehen, wie sie in zwei oder mehr der Unterklassen H10B, H10D, H10F, H10H, H10K oder H10N vorgesehen sind, z.B. Hybrid- Schaltkreise [2, 2006.01, 2023.01]
H01L 25/18	1-Punkt Untergruppe	. wobei die Bauelemente aus Arten bestehen, wie sie in zwei oder mehr verschiedenen Hauptgruppen ein- und derselben Unterklasse H10B, H10D, H10F, H10H, H10K oder H10N vorgesehen sind [5, 2006.01, 2023.01]
H01L 27/00	Gelöscht	(überführt nach H10D 99/00)
H01L 27/01	Gelöscht	(überführt nach H10D 86/85)
H01L 27/02	Gelöscht	(überführt nach H10D 1/20; H10D 1/47; H10D 1/68; H10D 88/00-H10D 89/60)
H01L 27/04	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/00)
H01L 27/06	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/40)
H01L 27/07	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/40)
H01L 27/08	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/00)
H01L 27/082	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/60-H10D 84/67)
H01L 27/085	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/82)
H01L 27/088	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/83-H10D 84/84)
H01L 27/092	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/85)
H01L 27/095	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/86)
H01L 27/098	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/87)
H01L 27/10	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/00)
H01L 27/102	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/40-H10D 84/60)
H01L 27/105	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/40; H10D 84/80)
H01L 27/118	Gelöscht	(überführt nach H10D 84/90)
H01L 27/12	Gelöscht	(überführt nach H10D 86/00; H10D 87/00; H10D 86/40-H10D 86/60)
H01L 27/13	Gelöscht	(überführt nach H10D 86/80-H10D 86/85)
H01L 27/14	Gelöscht	(überführt nach H10F 99/00)

Symbol	Typ	Titel
H01L 27/142	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/50)
H01L 27/144	Gelöscht	(überführt nach H10F 39/10)
H01L 27/146	Gelöscht	(überführt nach H10F 39/12; H10F 39/18)
H01L 27/148	Gelöscht	(überführt nach H10F 39/15)
H01L 27/15	Gelöscht	(überführt nach H10H 29/01; H10H 29/10-H10H 29/14; H10H 29/30-H10H 29/856)
H01L 29/00	Gelöscht	(überführt nach H10D 99/00)
H01L 29/02	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/00)
H01L 29/04	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/40)
H01L 29/06	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/10)
H01L 29/08	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/13)
H01L 29/10	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/17)
H01L 29/12	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/80-H10D 62/81)
H01L 29/15	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/815)
H01L 29/16	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/83)
H01L 29/161	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/832)
H01L 29/165	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/822)
H01L 29/167	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/834)
H01L 29/18	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/82; H10D 62/84)
H01L 29/20	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/85)
H01L 29/201	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/852)
H01L 29/205	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/824)
H01L 29/207	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/854)
H01L 29/22	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/86)
H01L 29/221	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/862)
H01L 29/225	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/826)
H01L 29/227	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/864)
H01L 29/24	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/80; H10D 62/82)
H01L 29/26	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/80)
H01L 29/267	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/82)
H01L 29/30	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/50)
H01L 29/32	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/53)
H01L 29/34	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/57)
H01L 29/36	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/60)
H01L 29/38	Gelöscht	(überführt nach H10D 62/00)
H01L 29/40	Gelöscht	(überführt nach H10D 64/00)
H01L 29/41	Gelöscht	(überführt nach H10D 64/20)
H01L 29/417	Gelöscht	(überführt nach H10D 64/23)
H01L 29/423	Gelöscht	(überführt nach H10D 64/27)
H01L 29/43	Gelöscht	(überführt nach H10D 64/60)
H01L 29/45	Gelöscht	(überführt nach H10D 64/62)
H01L 29/47	Gelöscht	(überführt nach H10D 64/64)
H01L 29/49	Gelöscht	(überführt nach H10D 64/66)
H01L 29/51	Gelöscht	(überführt nach H10D 64/68)
H01L 29/66	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/00; H10D 48/30)
H01L 29/68	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/32)
H01L 29/70	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/34)
H01L 29/72	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/34)
H01L 29/73	Gelöscht	(überführt nach H10D 10/00)
H01L 29/732	Gelöscht	(überführt nach H10D 10/40)

Symbol	Typ	Titel
H01L 29/735	Gelöscht	(überführt nach H10D 10/60)
H01L 29/737	Gelöscht	(überführt nach H10D 10/80)
H01L 29/739	Gelöscht	(überführt nach H10D 12/00)
H01L 29/74	Gelöscht	(überführt nach H10D 18/00)
H01L 29/744	Gelöscht	(überführt nach H10D 18/60)
H01L 29/745	Gelöscht	(überführt nach H10D 18/65)
H01L 29/747	Gelöscht	(überführt nach H10D 18/80)
H01L 29/749	Gelöscht	(überführt nach H10D 18/40)
H01L 29/76	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/36)
H01L 29/762	Gelöscht	(überführt nach H10D 44/00)
H01L 29/765	Gelöscht	(überführt nach H10D 44/40)
H01L 29/768	Gelöscht	(überführt nach H10D 44/45)
H01L 29/772	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/00; H10D 30/40)
H01L 29/775	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/43)
H01L 29/778	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/47)
H01L 29/78	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/60-H10D 30/66)
H01L 29/786	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/67)
H01L 29/788	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/68)
H01L 29/792	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/69)
H01L 29/80	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/80)
H01L 29/808	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/83)
H01L 29/812	Gelöscht	(überführt nach H10D 30/87)
H01L 29/82	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/40)
H01L 29/84	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/50)
H01L 29/86	Gelöscht	(überführt nach H10D 1/40; H10D 48/38)
H01L 29/8605	Gelöscht	(überführt nach H10D 1/43)
H01L 29/861	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/00; H10D 8/20)
H01L 29/862	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/30)
H01L 29/864	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/40)
H01L 29/866	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/25)
H01L 29/868	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/50)
H01L 29/87	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/80)
H01L 29/872	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/60)
H01L 29/88	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/70)
H01L 29/885	Gelöscht	(überführt nach H10D 8/75)
H01L 29/92	Gelöscht	(überführt nach H10D 1/62)
H01L 29/93	Gelöscht	(überführt nach H10D 1/64)
H01L 29/94	Gelöscht	(überführt nach H10D 1/66)
H01L 29/96	Gelöscht	(überführt nach H10D 48/00)
H01L 31/00	Gelöscht	(überführt nach H10F 99/00)
H01L 31/02	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/00)
H01L 31/0203	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/50)
H01L 31/0216	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/30)
H01L 31/0224	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/20)
H01L 31/0232	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/40)
H01L 31/0236	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/70)
H01L 31/024	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/60)
H01L 31/0248	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/10)
H01L 31/0256	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/12)

Symbol	Typ	Titel
H01L 31/0264	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/12)
H01L 31/0272	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/121)
H01L 31/028	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/122)
H01L 31/0288	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/1223)
H01L 31/0296	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/123)
H01L 31/0304	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/124)
H01L 31/0312	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/1226)
H01L 31/032	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/12)
H01L 31/0328	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/12)
H01L 31/0336	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/12)
H01L 31/0352	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/14)
H01L 31/036	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/16)
H01L 31/0368	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/164)
H01L 31/0376	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/166)
H01L 31/0384	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/162)
H01L 31/0392	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/169)
H01L 31/04	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/00)
H01L 31/041	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/80; H10F 10/00-H10F 19/90)
H01L 31/042	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/00)
H01L 31/043	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/40)
H01L 31/044	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/70)
H01L 31/0443	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/75)
H01L 31/0445	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/30)
H01L 31/046	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/31)
H01L 31/0463	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/33)
H01L 31/0465	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/35)
H01L 31/0468	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/37)
H01L 31/047	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/10)
H01L 31/0475	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/20)
H01L 31/048	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/80)
H01L 31/049	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/85)
H01L 31/05	Gelöscht	(überführt nach H10F 19/90)
H01L 31/052	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/63; H10F 10/00-H10F 19/90)
H01L 31/0525	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/67; H10F 10/00-H10F 19/90)
H01L 31/053	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/90; H10F 10/00-H10F 19/90)
H01L 31/054	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/42; H10F 10/00-H10F 19/90)
H01L 31/055	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/45; H10F 10/00-H10F 19/90)
H01L 31/056	Gelöscht	(überführt nach H10F 77/48; H10F 10/00-H10F 19/90)
H01L 31/06	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/10)
H01L 31/061	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/11)
H01L 31/062	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/12)
H01L 31/065	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/13)
H01L 31/068	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/14)
H01L 31/0687	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/142)
H01L 31/0693	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/144)
H01L 31/07	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/18)
H01L 31/072	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/16)
H01L 31/0725	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/161)
H01L 31/073	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/162)

Symbol	Typ	Titel
H01L 31/0735	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/163)
H01L 31/074	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/164)
H01L 31/0745	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/165)
H01L 31/0747	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/166)
H01L 31/0749	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/167)
H01L 31/075	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/17)
H01L 31/076	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/172)
H01L 31/077	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/174)
H01L 31/078	Gelöscht	(überführt nach H10F 10/19)
H01L 31/08	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/00)
H01L 31/09	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/10)
H01L 31/10	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/20)
H01L 31/101	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/21)
H01L 31/102	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/22)
H01L 31/103	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/221)
H01L 31/105	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/223)
H01L 31/107	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/225)
H01L 31/108	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/227)
H01L 31/109	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/222)
H01L 31/11	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/24)
H01L 31/111	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/26)
H01L 31/112	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/28)
H01L 31/113	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/282)
H01L 31/115	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/29)
H01L 31/117	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/292)
H01L 31/118	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/295)
H01L 31/119	Gelöscht	(überführt nach H10F 30/298)
H01L 31/12	Gelöscht	(überführt nach H10F 55/00)
H01L 31/14	Gelöscht	(überführt nach H10F 55/10)
H01L 31/147	Gelöscht	(überführt nach H10F 55/15)
H01L 31/153	Gelöscht	(überführt nach H10F 55/155)
H01L 31/16	Gelöscht	(überführt nach H10F 55/20)
H01L 31/167	Gelöscht	(überführt nach H10F 55/25)
H01L 31/173	Gelöscht	(überführt nach H10F 55/255)
H01L 31/18	Gelöscht	(überführt nach H10F 71/00)
H01L 31/20	Gelöscht	(überführt nach H10F 71/10)
H01L 33/00	Gelöscht	(überführt nach H10H 99/00; H10H 20/00-H10H 20/80)
H01L 33/02	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/81)
H01L 33/04	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/811)
H01L 33/06	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/812)
H01L 33/08	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/813)
H01L 33/10	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/814)
H01L 33/12	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/815)
H01L 33/14	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/816)
H01L 33/16	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/817)
H01L 33/18	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/818)
H01L 33/20	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/819)
H01L 33/22	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/82)
H01L 33/24	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/821)

Symbol	Typ	Titel
H01L 33/26	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/822)
H01L 33/28	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/823)
H01L 33/30	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/824)
H01L 33/32	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/825)
H01L 33/34	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/826)
H01L 33/36	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/83)
H01L 33/38	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/831)
H01L 33/40	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/832)
H01L 33/42	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/833)
H01L 33/44	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/84)
H01L 33/46	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/841)
H01L 33/48	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/85)
H01L 33/50	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/851)
H01L 33/52	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/852)
H01L 33/54	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/853)
H01L 33/56	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/854)
H01L 33/58	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/855)
H01L 33/60	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/856)
H01L 33/62	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/857)
H01L 33/64	Gelöscht	(überführt nach H10H 20/858)